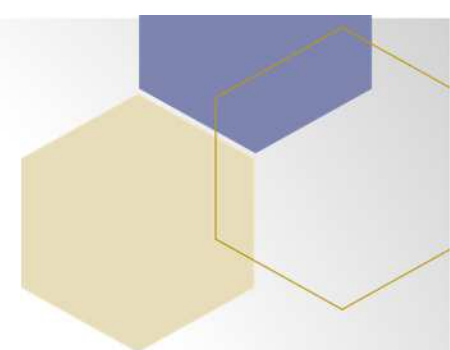




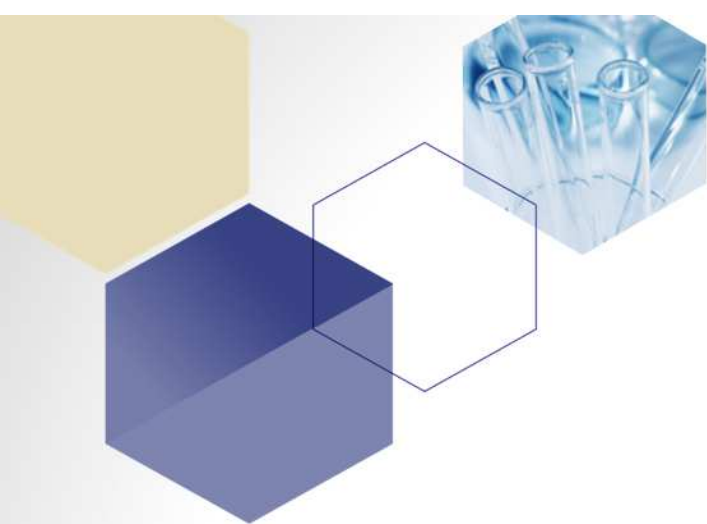
2027年3月期 第2四半期 決算説明資料



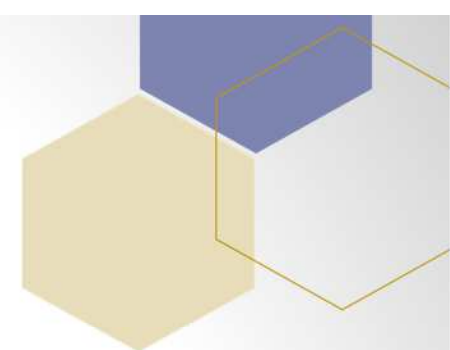
日本高純度化学株式会社

証券コード：4973

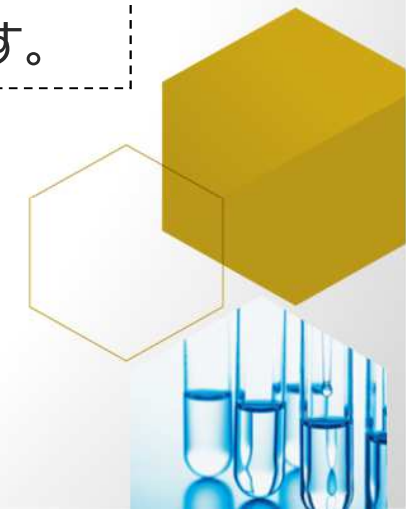
2026年10月27日



決算の概況



(注) 当社業績の見方のポイント

- 売上高は、薬品と一緒に貴金属を販売する場合と、薬品のみを販売する場合によって大きく変動します。
 - 貴金属は価格変動があり、かつ高価なため、売上高に大きく影響します。
- 

めっき方式の説明

用語	最終用途	説明
電解めっき	—	金属などの表面に電気を流してめっきする方法
純金めっき	PC・スマホ等のプリント基板（CPU・GPU等）	高純度な純金めっき
硬質金めっき	スマートフォン・車載・産業機械等のコネクター	合金成分を入れて硬くした合金めっき
パラジウムめっき	PC・車載・産業機械等のリードフレーム	金めっきの下地めっきとして使用される
無電解めっき	—	電気を流さず化学反応によりめっきする方法
置換金めっき	DRAM・NAND等の半導体メモリ サーバ・PC・スマートフォン等の半導体 パッケージ基板	金属ごとの溶けやすさ（イオン化傾向）を利用し、下地金属の表面を置き換えて形成するめっき方法
還元金めっき	半導体パッケージ基板 サーバ・PC等のCPU・GPU等	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法
還元パラジウムめっき	サーバ・PC等の半導体パッケージ基板	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法（金めっきの下地として使用される）

製品ラインアップ

めっき方式		用途	製品ラインアップ	
電解	純金		① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき	テンペレジストシリーズ
	硬質金		マイクロコネクタ用省金硬質金めっき	オーロブライト BAR7
	パラジウム		PPF用薄膜パラジウムめっき (PPF: Pre Plated Lead frame)	パラブライト NANO2
無電解	置換金		中～高リンニッケルで使える置換金めっき 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき ニッケル不使用置換金めっき	IM-GOLD IB2X IM-GOLD CN IM-GOLD PC
	還元金		亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき シアン化金を使った薄膜還元金めっき	HY-GOLD HY-GOLD CN
	還元パラジウム		ENEPIG用還元パラジウムめっき ニッケル不使用還元パラジウムめっき	ネオパラブライト 2 ネオパラブライト DP
周辺分野			卑金属（銅、スズ、ニッケル）、合金めっき、後処理剤など	

めっきプロセスの説明

用語	説明	めっき層構成
ENIG	銅上に無電解ニッケルめっき及び置換金めっきをする方法。 層構成はCu-Ni-Au Electroless Nickel Immersion Goldの略	Au 0.06μm Ni 2-7μm Cu 15-30μm
ENEPIG	銅上に無電解ニッケルめっき、無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法 薄ニッケル化の動きが進んでいる。 層構成はCu-Ni-Pd-Au Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Goldの略	Au 0.06μm Pd 0.04μm Ni 0.15-7μm Cu 15-30μm
DIG	銅上に置換金めっきを直接する方法。Niめっきを省いているためENIGに比べファインピッチ対応が可能。 層構成はCu-Au Direct Immersion Goldの略	Au 0.06μm Cu 15-30μm
EPIG	銅上に無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。 層構成はCu-Pd-Au Electroless Palladium Immersion Goldの略	Au 0.06μm Pd 0.04μm Cu 15-30μm

2027年3月期 第2四半期外部環境

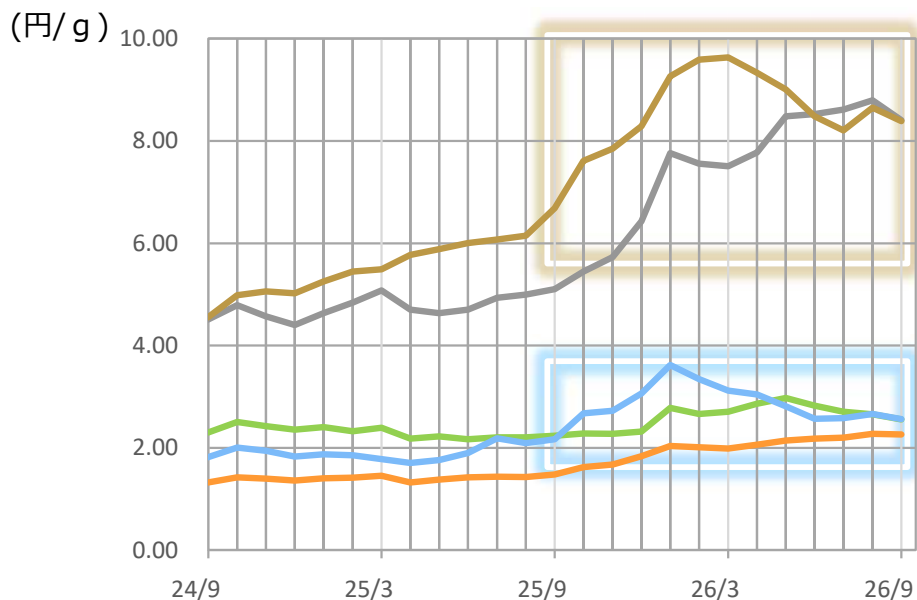
電子部品業界の状況

- 電子部品業界では、生成AI・データセンター向け需要は堅調な一方、汎用メモリ等の部材供給逼迫が足かせとなり、関連機器の生産・出荷は想定を下回った
- スマホ向けは汎用メモリ不足と価格高騰で需要が低迷、PC向けも単価上昇で売上高は維持したものの出荷台数は減少
- 産業機械向けは、生成AIやデータセンター向けの設備投資を背景に、堅調に推移
- 車載向けは国内・北米に下支えされたものの、地域ごとの回復にばらつきがあり伸びは緩やか

貴金属の概況

Copper 銅
Tin スズ
Nickel ニッケル

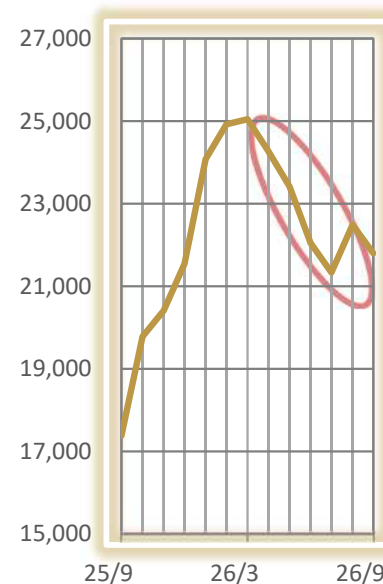
銅、スズ、ニッケル価格（左軸）



金、パラジウム価格（右軸）

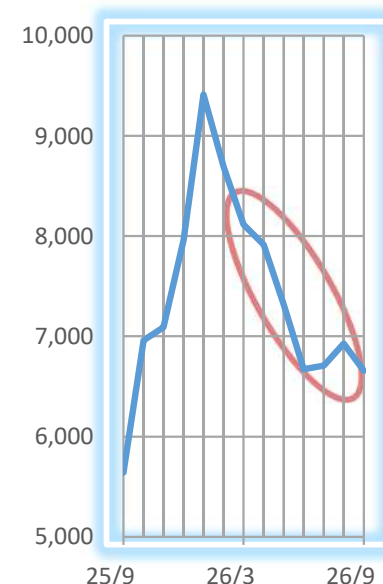
Gold 金

（円/g）



Palladium パラジウム

（円/g）



2027年3月期 第2四半期決算概況（累計）

当社の決算概況：増収減益

- 売上高：汎用メモリ等の部材供給不足による制約もみられる中、生成AI関連をはじめ、産業機械や民生向けなど幅広い需要の堅調な推移に加え、貴金属価格の上昇※¹も寄与し、前年同期比57.6%の増収
- 営業利益：人的投資や研究開発費への先行投資及び上期における貴金属価格下落※²に伴う一過性の要因により、前年同期比△80.5%の減益
- 四半期純利益：営業利益は減少も、政策保有株式売却等により前年同期比+11.3%の増益

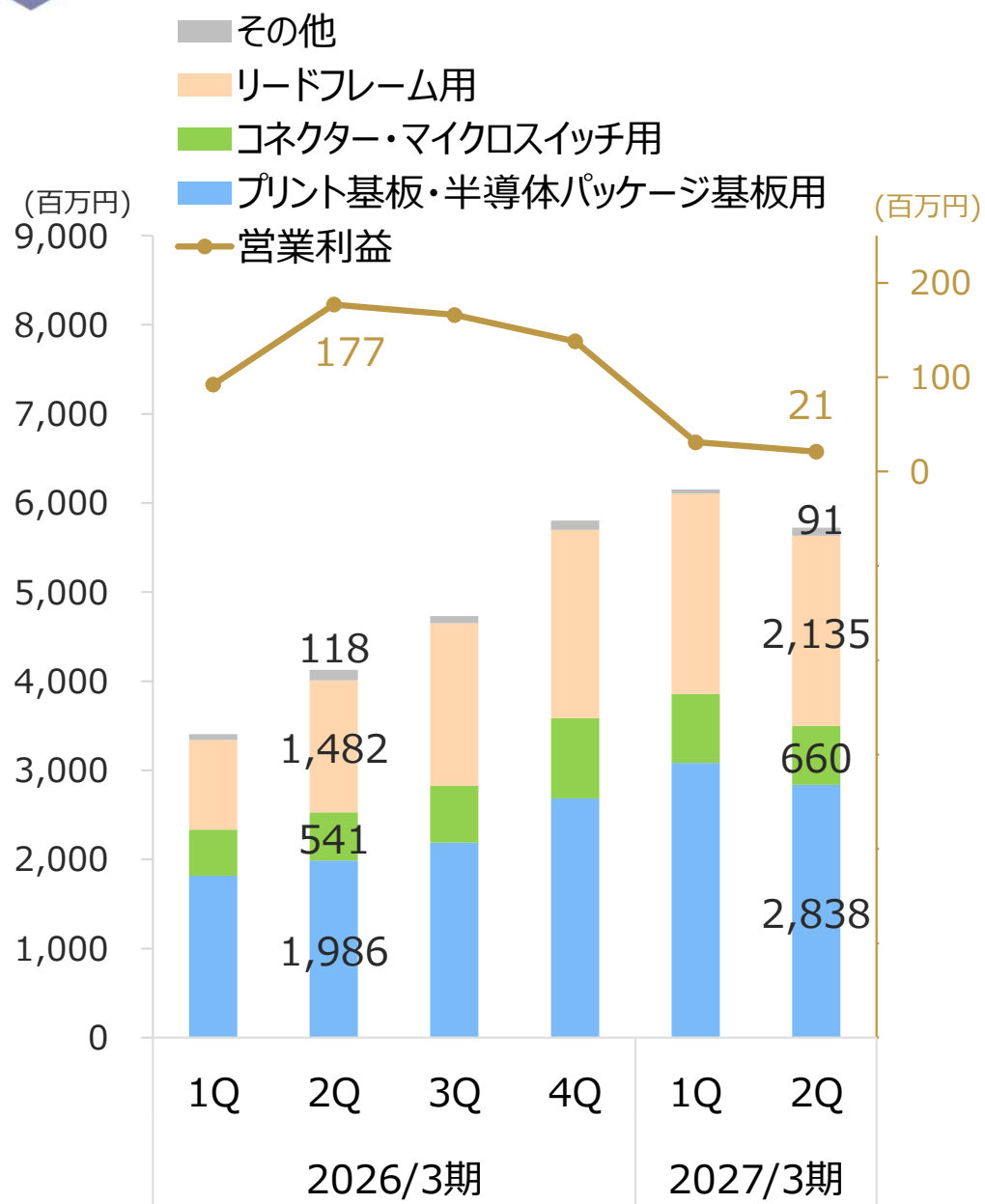
(単位：百万円)	2026/3期	2027/3期			
	2Q累計	1Q	2Q	2Q累計	増減率
売上高	7,536	6,152	5,725	11,878	+57.6%
営業利益	271	31	21	53	△80.5%
経常利益	378	122	46	169	△55.1%
四半期純利益	624	88	606	694	+11.3%
1株当たり 四半期純利益	108.04円	15.25円	104.26円	119.60円	—

貴金属価格（単月平均、1gあたり）

※1 前年同期比（2025年9月→2026年9月） 金：17,380→21,800円（+25%）、パラジウム：5,642→6,657円（+18%）

※2 前期比（2026年3月→2026年9月） 金：25,047→21,800円（-13%）、パラジウム：8,116→6,657円（-18%）

売上高・営業利益の推移

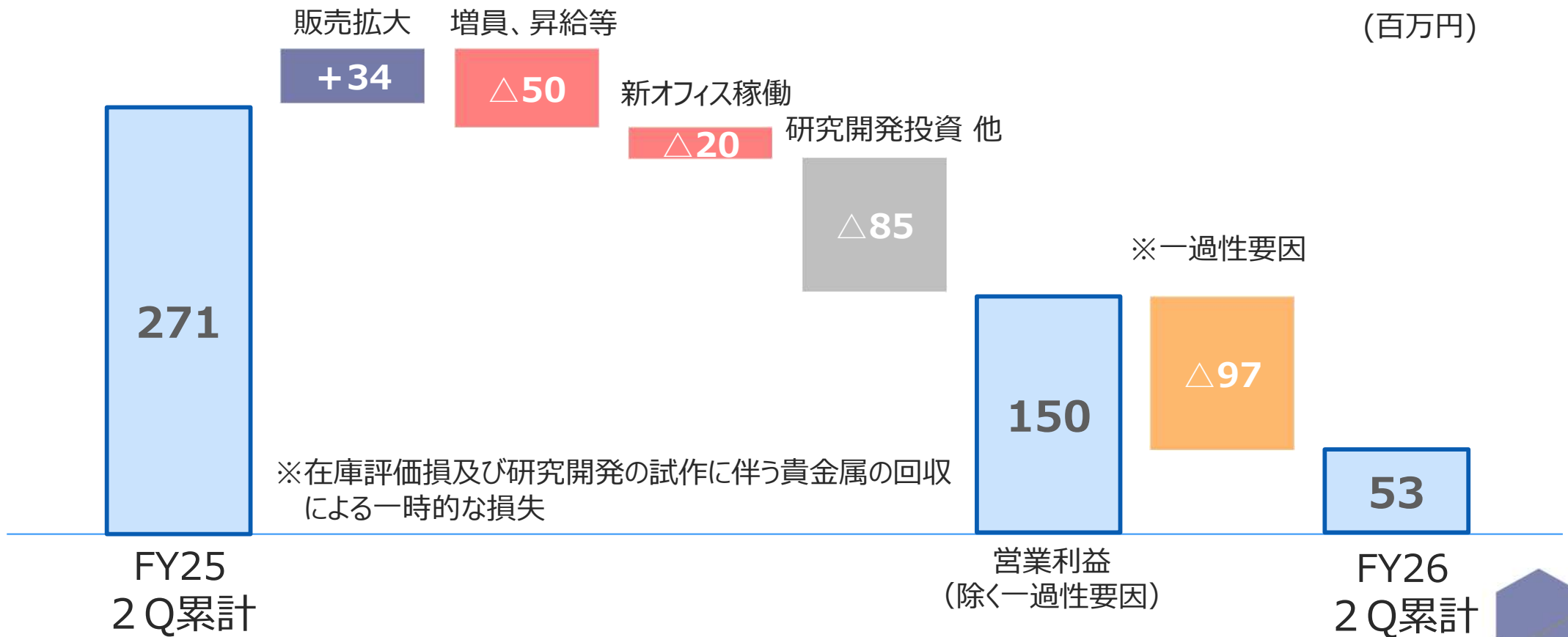


カテゴリー別概況（前年同四半期比）

- プリント基板・半導体パッケージ基板用めっき薬品
プリント基板はパソコン・スマートフォン向け低価格帯が減少したもののハイエンド製品向けが想定を上回って好調に推移、半導体パッケージ基板もAIサーバー向けが好調に推移したほか、貴金属価格上昇の影響もあり増収
- コネクタ用めっき薬品
スマートフォン向けは横ばいで推移、車載向けは電装化の進展で回復、産業機器向けは生成AI向けの需要増加により増収
- リードフレーム用めっき薬品
AIサーバーの需要に牽引され、車載・産業機械が堅調に推移したことに加え、貴金属価格上昇の影響もあり増収

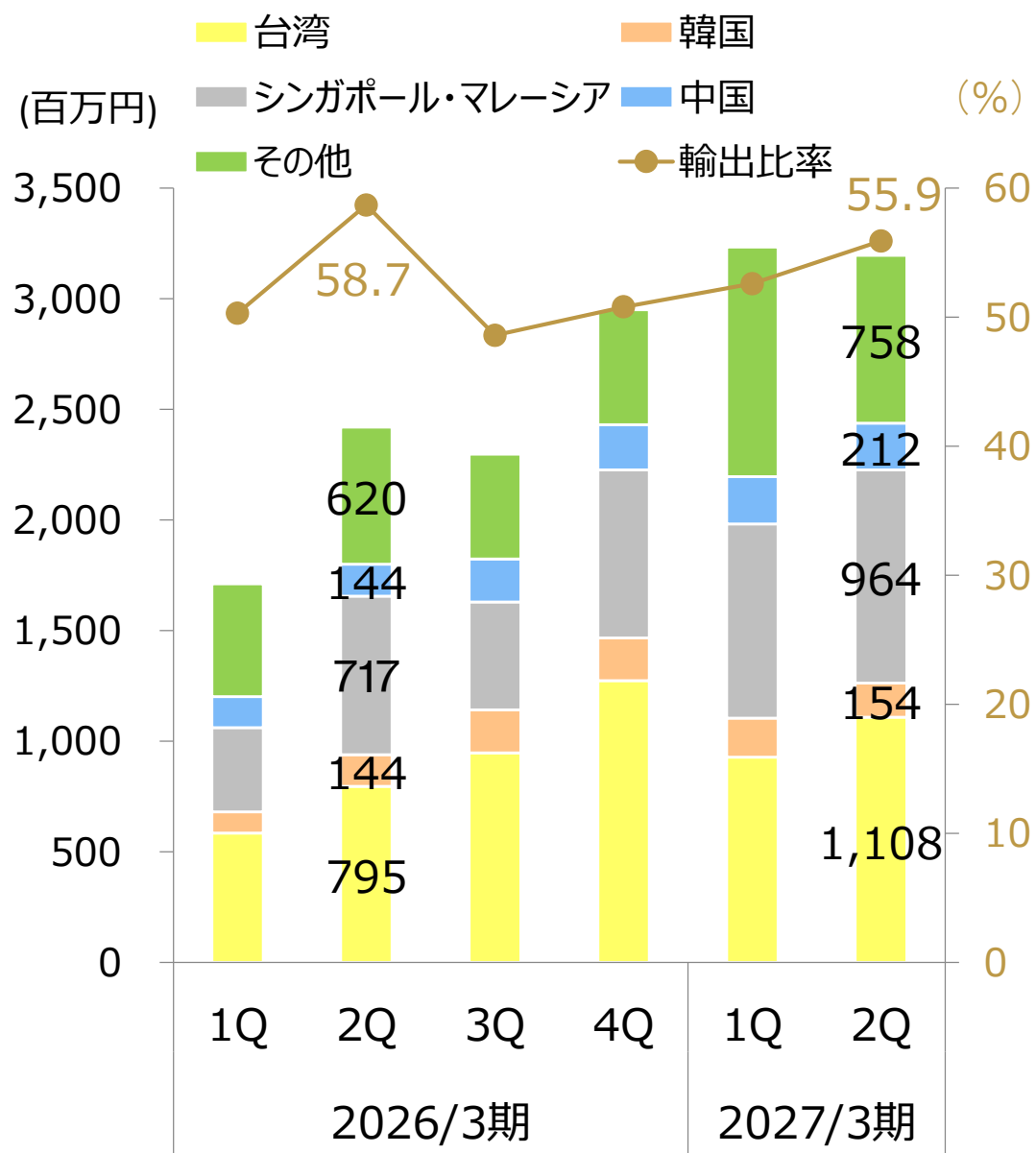
営業利益増減要因（前年同期比）

- AI関連需要を背景にメモリ向け需要は堅調だったものの、汎用メモリ等の部材供給不足により、メモリ基板向けの販売が伸び悩んだ。一方、コネクタ、PCB、リードフレーム向けは、スマートフォン、産業機器、民生向け需要を背景に堅調に推移し、全体の販売数量は微増
- 人的資本や研究開発への先行投資を計画通りに実施したことに加え、貴金属価格下落に伴う一過性の要因により、営業利益は減少



注) 当社は為替予約により為替変動の影響を最小限に留めています

輸出地域別売上高の推移（四半期ベース）



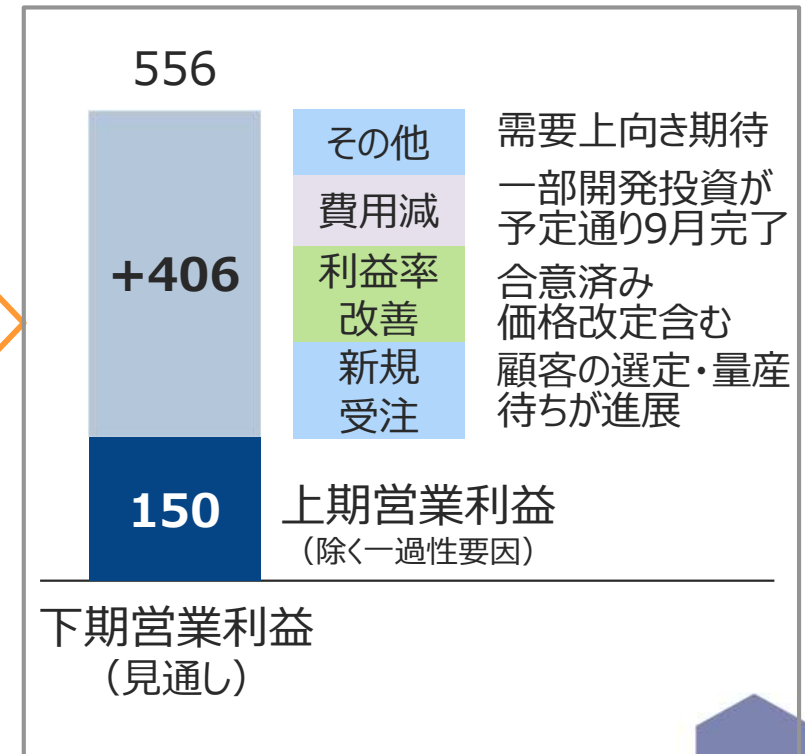
増減理由（前年同四半期比）

- 台湾
AIサーバー向け光通信モジュール及び産業機械・車載向けリードフレーム用途が堅調に推移し、貴金属価格の上昇も背景に増収
- シンガポール・マレーシア
産業機械向けのリードフレームが回復傾向にあり、パソコン・AIサーバー向けパッケージ用途も堅調に推移し、貴金属価格の上昇も背景に増収
- その他
フィリピンにおけるパソコン・サーバー向けパッケージ用途の需要増により増収

2027年3月期 見通し

- 汎用メモリ等の部材供給の逼迫により一部民生向け需要の回復は緩やかだが、AI関連需要は引き続き旺盛
- 人的資本・研究開発への投資を継続し、中長期的な成長基盤を強化
- 政策保有株式の売却は、今期売却予定銘柄について概ねスケジュールどおり進捗
- 上期の貴金属価格変動による影響は残るも、遅れていた新規受注獲得に加え、製品価格改定の効果や費用効率化等を下期に織り込み、通期予想に変更なし

(単位：百万円)	2027/3期		
	(期初予想)	上期実績	下期見通し
売上高	24,000	11,878	12,122
営業利益	610	53	556
経常利益	800	169	630
投資有価証券売却益	2,100	770	1,329
当期純利益	2,170	694	1,475
1株あたり配当	230円	115円	115円



政策保有株式売却の進捗

- 当社は政策保有株式について、中期経営計画 FY2025-2027の期間中に純資産割合を20%未満に縮減する方針を掲げています
- 保有銘柄の株価が大きく上昇したことにより、結果として保有株式の時価は前年度末から増加しました
- 期初に策定した計画に沿って政策保有株式の売却を推進しております

	2025年 9月末	2025年 12月末	2026年 3月末	2026年 6月末	2026年 9月末
売却額 ※ （百万円）	493	933	315	—	906
保有株式時価（百万円）	8,416	9,308	10,743	17,956	14,885
純資産額（百万円）	15,566	16,659	18,064	22,315	20,957
純資産に対する割合（%）	54.1	55.9	59.5	80.5	71.0

※ 該当四半期中での売却額

トピック: SEMICON Taiwan2026 出展

- 半導体分野における顧客開拓に向け、世界の半導体技術を牽引する台湾企業との接点を獲得
- 当社および当社製品の認知度向上と台湾の市場/技術動向を把握

開催概要

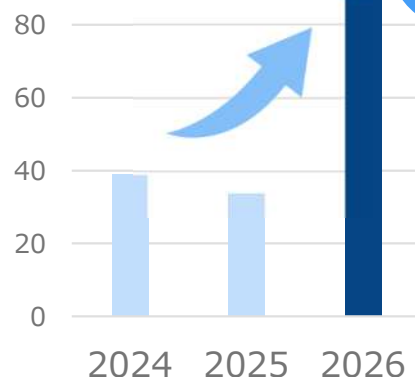
期間：2026年9月2日～4日

会場：台北 TaiNEX ホール1&2

規模：出展1,300社超
(約4,300ブース)

2024年より
毎年出展

商談創出件数



前年比
2.5倍

当社ブースの様子



当社の技術講演の様子



光通信用化合物半導体から最先端AIアクセラレータの
パッケージ基板まで用途に応じた貴金属めっき技術を提案

☑ 光通信用化合物半導体向け | シアンフリー金めっき

膜厚均一性・ビア埋め込み性・表面平滑性を訴求
(GaAs・GaN・InPなど向け) (表面粗さ：Sa 20nm未満)

☑ 最先端AIアクセラレータ向け | パッケージ用途のめっき技術

最先端の用途を見据え、Au・Pdめっきの結晶制御技術を提案
(Auめっきは高硬度の実現、Pdめっきはバリア性能の向上)

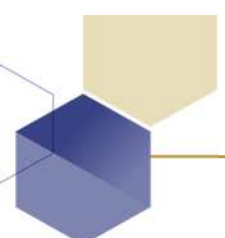
補足資料：会社紹介

沿革

- 1971年 7 月 会社設立
- 1999年 11月 MBOを実施
- 2002年 12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年 3 月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年 3 月 東京証券取引所市場第一部に上場
- 2019年 2 月 一般財団法人JPC奨学財団設立
- 2020年 4 月 公益財団法人JPC奨学財団に認定
- 2022年 4 月 東京証券取引所プライム市場に移行
- 2026年 3月 成増オフィス開設

事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき薬品に絞り世界シェアトップクラス
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを保有しないファブライト企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献



注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2026年9月末時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>